

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2026-042

芯联集成电路制造股份有限公司

2026 年前三季度业绩预告的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日（以下简称“报告期”）。

（二）业绩预告情况

（1）经财务部门初步测算，预计 2026 年前三季度营业收入约为 77.66 亿元，较上年同期增加约 23.44 亿元，同比增长约 43.23%。

（2）公司预计 2026 年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润约 6.81 亿元，较上年同期增加约 11.44 亿元，与上年同期相比增长约 247.08%，较去年同期实现扭亏为盈。

（三）公司本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

（1）营业收入：54.22 亿元。

（2）归属于母公司所有者的净利润：-4.63 亿元。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内，受全球半导体产业的技术迭代、需求升级与场景渗透的多重驱动，以及 AI 等新兴应用领域持续拓展，公司积极拓展市场、持续深化客户合作，充分把握国产替代带来的机遇，推动业务规模持续扩张。

在收入端，随着系统技术平台的不断深入，公司进一步加强与客户的深度和全方位合作，保持高水位产能利用率，产品结构不断优化，有力推动公司收入实现快速增长；在盈利端，销售放量所释放的规模效应、成本管控的扎实推进、工厂运营效率的持续优化，叠加产品结构升级与附加值提升，共同构筑了公司产品盈利能力的坚实支撑。同时，公司技术授权业务的稳步推进，亦将对归母净利润产生有利影响。

四、风险提示

截至本公告日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2026 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日